

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 关于公司及子公司申请银行授信额度及公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司上海帝福申请授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

#### 一、授信及担保情况概述

由于公司及全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（简称“上海帝福”）2023年度在相关商业银行的授信额度即将到期，现为满足公司业务发展需要，公司及上海帝福拟向相关商业银行新申请一年期综合授信额度，具体情况如下：

##### 1. 关于公司拟向江苏银行股份有限公司上海黄浦支行申请授信额度

公司拟向江苏银行股份有限公司上海黄浦支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币12,500.00万元（含12,500.00万元），用于办各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、单一风险资产池（以银行存单、银行承兑汇票、保证金等作为质押物）以及开立信用证等综合业务。该授信额度为纯信用无担保方式，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

##### 2. 关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度

现公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币12,500.00万元（含12,500.00万元），用于办各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、单一风险资产池（以银行存单、银行承兑汇票、保证金等作为质押物）以及开立信用证等综合业务。该授信额度为纯信用无担保方式，具

体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

### **3. 关于公司及全资子公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请授信额度及公司为全资子公司提供信用担保**

现公司及全资子公司上海帝福拟向中信银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度，其中公司拟申请综合授信额度为最高不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元），上海帝福拟申请综合授信额度为最高不超过人民币 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元）均用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、单一风险资产池（以银行存单、银行承兑汇票、保证金等作为质押物）以及开立信用证等综合业务。公司的授信额度为纯信用无担保方式，上海帝福的授信额度由公司为提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

### **4. 关于公司及全资子公司拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请授信额度及公司为全资子公司提供信用担保**

现公司及全资子公司上海帝福拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行新申请一年期综合授信额度，其中公司拟申请综合授信额度为最高不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元），上海帝福拟申请综合授信额度为最高不超过人民币 6,000.00 万元（含 6,000.00 万元），均用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、单一风险资产池（以银行存单、银行承兑汇票、保证金等作为质押物）以及开立信用证等综合业务。公司的授信额度为纯信用无担保方式，上海帝福的授信额度由公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

以上公司及子公司拟向银行申请授信事宜，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

## **二、被担保人基本情况**

- 1、公司名称：上海帝福新材料科技有限公司
- 2、成立日期：2018 年 10 月 17 日
- 3、注册地点：上海市奉贤区银工路 688 号
- 4、法定代表人：郭菊涵
- 5、注册资本：7,200.00 万元

6、经营范围：一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；货物进出口；电子专用材料制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持有上海帝福 100%的股权，为公司全资子公司

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标	2024年6月30日/2024年1-6月	2023年12月31日/2023年度
资产总额	10,195.56	18,535.58
负债总额	3,049.91	15,761.16
净资产	7,145.65	2,774.43
营业收入	1,369.26	6,989.17
利润总额	-302.91	358.71
净利润	-328.78	299.10

备注：上表所列 2023 年 12 月 31 日/2023 年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月的财务数据未经审计。

9、上海帝福信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、协议的主要内容

上述公司及子公司上海帝福申请银行综合授信并由公司为子公司提供担保事宜，经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据银行的实际审批结果签署相关协议，但最终授信额度及对子公司担保额度不超过本议案审议的范围。截至本报告披露日，公司及子公司上海帝福尚未签署相关协议。

### 四、审议程序与相关意见

公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司上海帝福申请授信额度及担保事项的议案》，会议表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司于同日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司上海帝福申请授信额度及担保事项的议案》，会议表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本

次会议中，出席会议的监事朱严女士作为关联方回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为：公司及子公司申请银行授信额度是基于公司及子公司 2024 年生产经营和业务发展的需要，有利于公司及子公司实际业务的开展，提高公司的盈利水平，符合公司的整体利益。且公司为全资子公司提供担保事宜，风险相对可控，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响。公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额为 143,300.00 万元，实际已发生的担保总余额为人民币 31,949.40 万元，占上市公司最近一期经审计（2023 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东净资产的比例为 29.71%，以上担保均为对公司或子公司的担保，无其他对外担保。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

## 六、备查文件

- 1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日